



Rundbolzen/Walzplatten *Billets/Cakes*

MB-ETP

Bezeichnung

Sauerstoffhaltiges Kupfer

Designation

Oxygen containing copper

Spezifikationen

Specifications

Elektrische Leitfähigkeit <i>Electric conductivity</i>	Chemische Zusammensetzung <i>Chemical composition</i>	Gesamtverunreinigung ohne Ag <i>Sum of all impurities except Ag</i>	Beständigkeit gegen Wasserstoffversprödung <i>Resistancy against hydrogen-embrittlement</i>
58,0 Sm/mm ² (100 % IACS)	Cu ≥ 99,95% * Ag ≤ 150 ppm O ≤ 400 ppm Bi ≤ 5 ppm Pb ≤ 50 ppm	< 300 ppm	(Test nach ISO 2626): nicht relevant (Tested according to ISO 2626): no relevance

* incl. Ag

Anwendung

- Herstellung von Halbzeug ohne Anforderungen an Wasserstoffbeständigkeit, Schaltgeräte, Zubehör, allgemeine Elektrotechnik
- Schallgeräte
- allgemeine Elektrotechnik

Application

- Production of semi-finished products without hydrogen resistancy requirement, switch gears, accessories, general electroechnology
- Sound equipment
- General electrical perposes

Vergleich mit internationalen Normen

Comparison with international standards

NORM Regelwerk <i>Standard</i>	Bezeichnung <i>Name</i>	Abweichung im Vergleich zur angeführten Norm <i>Deviation from mentioned standard</i>
EN 1976	Cu-ETP (CR 004 A)	Kontrollierte Gussdichte je nach Weiterverarbeitung und Anwendung <i>Cast density control depending on further processing and application</i>
ASTM B5	Cu-ETP (C11000)	geringerer Verunreinigungsgehalt <i>Lower impurity concentration</i>